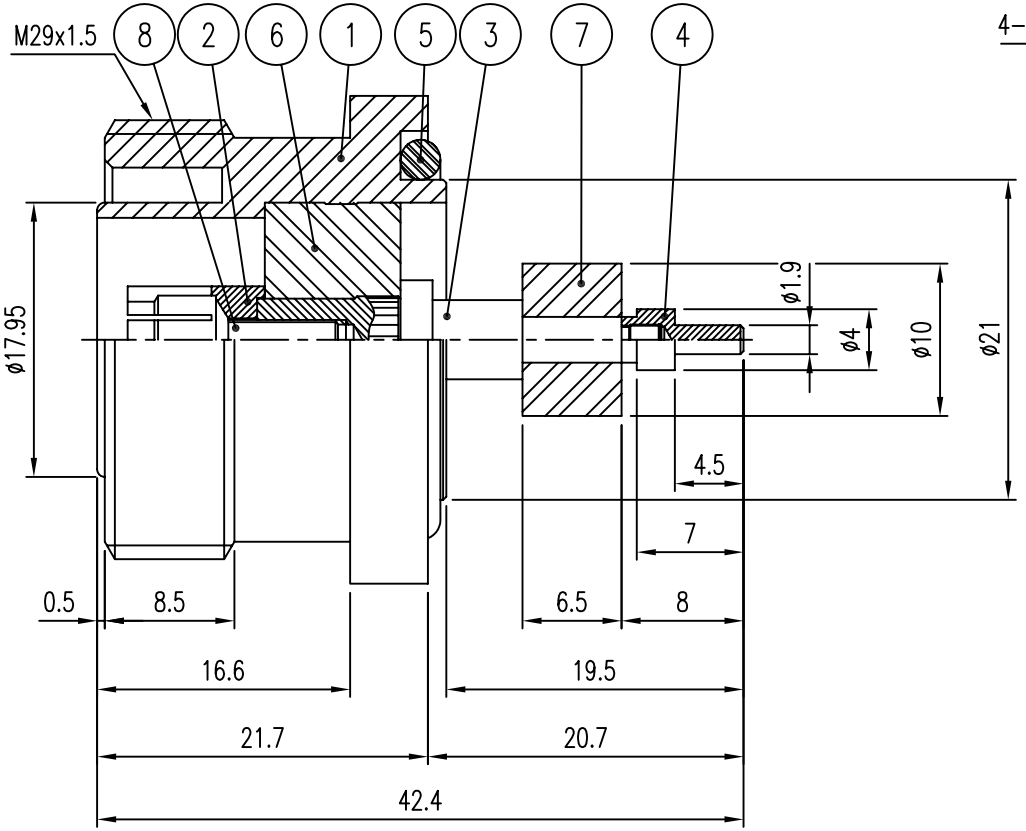
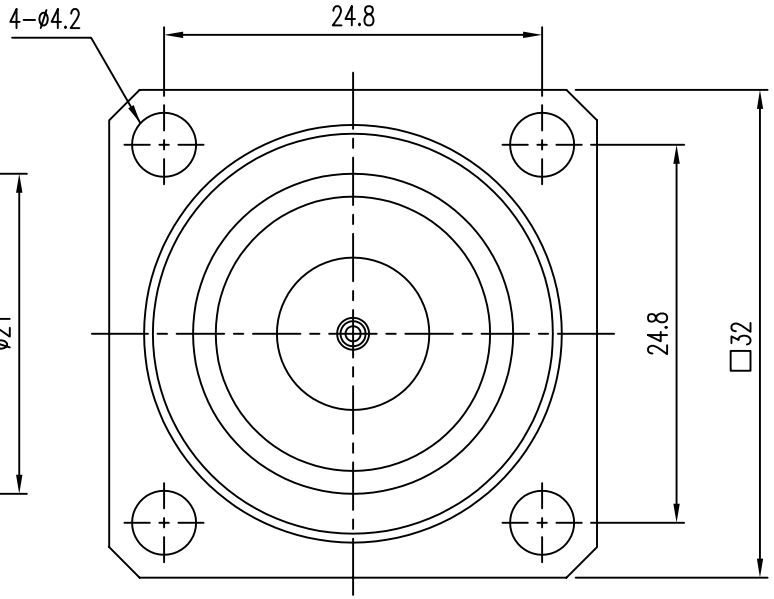
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
8	BOLT	1	SUS303	M2.6x8 접시머리	DBT00102-N/1
7	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01278-N/1
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01302-N/1
5	GASKET	1	SILICONE RUB	P-21	DGK00185-N/1
4	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate(7㎛)	DCT01547-5/1
3	CONTACT	1	MBsBD	Silver Plate(7㎛)	DCT01548-5/1
2	CONTACT	1	BeCu	Silver Plate(7㎛)	DCT01549-5/1
1	BODY	1	MBsBD	SUCO Plate (6㎛)	DBD02024-5/1

< 주 기 >

1. 품번②CONTACT와 품번③CONTACT 나사 체결 시 LOCTITE 도포 할 것.
2. 위 조립 한 CONTACT와 품번⑧BOLT 나사 체결 시 LOCTITE 도포 할 것.

대체가능재질	년월일	2008. 5. 20.	KJ COMTECH CO.,LTD.	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	승인			
	검도		도명	DIN7/16-J-H4-R
재질	제도			
열처리	작성부서	연 구 소	A4	도번 CN02027-7/1
보호피막처리	척도 2/1	단위 mm	중량	